

UL File No:E93618 / MIL-I-46058C / IPC-CC-830B

用途

CE-1164 採用 PU 樹脂合成的防水、耐溶劑絕緣保護膠，專用在印刷電路板及電子零件，防潮、防霉、防碰撞、防腐蝕及絕緣等用途上，提供出色的電氣和防潮屏障。

特點

- 單劑、低稠度，操作容易。
- 快速硬化，硬化後具柔韌性，且可 UV 檢測。
- 優異防潮穩定性。
- 對酚醛和環氧玻璃層壓板具出色的附著力。
- 符合 UL94 V-0 標準及 RoHS 2.0 規範。

操作注意事項

- PC 板或電子零件在噴塗前必須先作表面處理(如去油脂，去灰塵，乾燥等)，以利於膠和底材之結合。
- 可用噴塗、含浸或塗刷方式上膠，若需稀釋可搭配稀釋劑 S-8 來調低黏度，以利作業。
- S-8 可用來清洗被 CE-1164 所沾染的產品、器材等。
- 部分噴霧應用可能需要按體積稀釋至 1：1，以避免結網情況，第二層須在第一層表面乾後再噴，建議至少噴二層效果較佳(建議總硬化膜厚為 2±1mil)。
- 不建議在相對濕度小於 30%或大於 70%的地方使用 CE-1164。

基本物性

顏色：	透光、淡琥珀色
黏度：@25°C	100 cps
比重：@25°C	1.05
固成分：45分, 135°C	50%
閃火點：ASTM D93	7°C (45°F)
NCO值(含量)：ASTM D3960	4.4 pounds/gallon
稀釋劑：	S-8



硬化後物性

絕緣電阻：	MIL-I-46058C, 初期, @25°C, 2mils	2.5 x 10 ¹³ ohms
	MIL-I-46058C, 10天後, @65°C/95% R.H.	1.3 x 10 ¹⁰ ohms
絕緣強度：	ASTM D149, @25°C	3500 volts/mil
絕緣耐壓：	MIL-I-46058C, 1500V A.C.	無擊穿或破壞
絕緣常數：	ASTM D150, @25°C, 1 MHz	2.7
消散因數：	ASTM D150, @25°C, 1 MHz	0.02
體積電阻：	ASTM D150, @25°C	1.5 x 10 ¹⁵ ohm-cm
耐溶劑性：		優良
可焊錫性：		優良
防潮性：	MIL-I-46058C, @85°C/95%R.H.	無變色或退化
柔韌性：	MIL-I-46058C, 彎曲1/8"	無裂縫產生
耐熱衝擊性：	MIL-STD-810B, -65~125°C循環試驗	無開裂或變形
防霉性：	ASTM G-21	無營養

硬化條件

- 指乾時間：塗層置於常溫下，約 20~30 分鐘可表面乾燥不沾手。
- 硬化時間：(擇一進行即可)
 - 25°C x 24 小時(於室溫下進行 5-7 天的後硬化，可獲得最佳物理及電氣特性)
 - 60°C x 3 小時(於室溫下進行 2-3 天的後硬化，可獲得最佳物理及電氣特性)

保存

- 請儲存於常溫(@25°C)、乾燥且陰涼處，避免陽光直射。
- CE-1164 易與空氣中的水氣會產生反應，請避免暴露在空氣中，以免縮短保存期限，開罐後再密封前，最好噴氮氣以延長保存期限。
- 請勿在有明火或火花情況下使用產品。
- 保存期限：@25°C(未開封)，12 個月。